

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

聚辰半导体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研	<input type="checkbox"/> 分析师会议	<input type="checkbox"/> 媒体采访	
	<input type="checkbox"/> 业绩说明会	<input type="checkbox"/> 新闻发布会	<input type="checkbox"/> 路演活动	
	<input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 其他		
参与单位	广发证券	海富通基金	富国基金	申万宏源证券
	正圆基金	汇添富基金	华泰证券	闻天投资
	神农投资	同泰基金	九泰基金	华泰柏瑞基金
	德邦基金	淡水泉投资	信泰人寿	国华兴益保险资管
	中意资管	淳厚基金	瓴仁投资	PUDONG SCIENCE AND TECHNOLOGY
	上银基金	乾元资产	兴证全球基金	HSBC Global Asset Management
	途灵资产	招银理财	POINT72	太平基金
	华安基金	方正证券	荷和投资	财通资管
	天风资管	鹏扬基金	国联安基金	中国人保资管
	统一投信	瑞华投资	华能贵诚信托	兴业银行
	东方阿尔法基金	开思基金	华泰资管	中英人寿保险
	锦道投资	长江养老	榕树投资	中信保诚基金
	中信证券	博时基金	东盈投资	中海基金
	新华基金	鑫元基金	财通基金	Foundation Asset Management
	创金合信基金	平安基金	德华创投	猎投资本
	国泰基金	富安达基金	安联基金	常春藤基金
	天风证券	招商基金	圆信永丰基金	中信证券
	英大证券	盘京投资	中国银河证券	招商信诺资管
	信达澳亚基金	合众资产	聚沆资本	煜诚基金

	华泰保兴基金	中泰证券	风和资本	巴克莱银行
	Cephei Capital	Dymon Asia	Optimas	中兵财富资产
	中加基金	国寿养老	仙人掌基金	传奇投资
	Pinpoint Asset	信德投资	兴业基金	华安合鑫基金
	南方基金	君龙寿险	和洋投资	善思投资
	嘉实基金	奇盛基金	安信基金	宝盈基金
	宽行基金	德汇投资	开源证券	弘开投资
	恒生前海基金	日兴资管	晨曦投资	摩根士丹利基金
	中金公司	景顺长城基金	泰康资管	源峰基金
	生命人寿保险	百嘉基金	第一创业证券	红土创新基金
	融通基金	诺安基金	贝莱德资管	运舟资本
	邦德资产	鑫巢资本	鹏华基金	国寿资管
	大成基金	广发基金	太保资管	交银施罗德基金
	中信资管	东北证券		
活动时间	2026年3月23日			
活动地点	网络会议			
接待人员	职 务		姓 名	
	董事、董事会秘书		翁华强	
	全球市场副总裁		邵 丹	
	投资者关系总监、董事会办公室副主任		孙 远	
活动主要内容	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>公司董事、董事会秘书翁华强先生向与会投资者介绍了公司 2025 年的经营情况。</p> <p>二、投资者交流环节</p>			

1、去年营收利润同比增长的原因

2025年公司实现营业收入12.21亿元，较上年同期增长18.77%，归母净利润为3.64亿元，同比分别增长25.25%，均创下历史同期最好成绩。这主要系受益于公司近年来持续完善在高附加值市场的产品布局，2025年公司DDR5 SPD芯片、汽车级EEPROM芯片和高性能工业级EEPROM芯片的出货量较上年实现快速增长，光学防抖式（OIS）摄像头马达驱动芯片搭载在主流智能手机品牌的多款中高端机型实现商用，产品销售结构得到进一步优化，成为公司收入规模扩张和盈利能力提升的重要驱动力。

2、VPD芯片进展

公司与牵头制定行业标准及产品规范的全球领先存储厂商合作，率先推出配套下一代高性能存储设备的VPD芯片，用于提供关键参数管理、设备识别及系统级校验能力，成为首家进入该公司产品设计验证阶段、支持其新一代EDSFF eSSD模组和CXL内存模组的VPD芯片开发商。

3、AI眼镜应用情况

公司积极把握AI向智能终端设备渗透发展所带来的市场发展机会，WLCSP EEPROM芯片在行业主要品牌的AI眼镜产品中取得大规模应用，产品出色地满足了AI眼镜对于低功耗、高静电防护能力等方面的需求，有望成为产品线今后的重要增长引擎。

4、汽车市场拓展情况

公司积极进行欧洲、美国、韩国、日本、东盟等海外重点市场的拓展，汽车级EEPROM芯片成功导入多家全球领先的汽车电子Tier1供应商，广泛应用于全球前20大中的16大、以及国内前20大的全部汽车品牌的核心元器件，产品的销量和收入占公司整体业务的比重快速提升，进一步丰富了公司的业务结构，在扩大业务广度和市场覆盖面的同时，有效提升了公司的整体盈利能力和抗风险能力。

5、工业控制领域应用情况

公司在工业应用市场具有较深厚的积累，工业级存储芯片现已广泛应用于工业自动化（如伺服控制、机器人、人机交互）、数字能源（如光储充一体、逆变器）以及通信基站（如高速光模块）等领域，市场份额快速提升，现已发展成为高性能工业级 EEPROM 芯片的领先品牌，与众多全球领先的设备厂商形成了长期稳定的合作关系。

6、光学防抖式（OIS）驱动芯片的进展

公司多款光学防抖式驱动芯片搭载在行业主要智能手机厂商的中高端机型实现商用，成为产品线销售收入和毛利润增长的核心驱动力和新增长点，并有望在更为广泛的应用市场和客户群体中大批量供货。

7、NFC 芯片进展

公司多个规格型号的 NFC 芯片通过下游终端，客户的测试验证，主要应用场景包括电子价签、消费电子产品与智能家居装置、大型家电与小型家用设备、包装配件与品牌互动、轻工业与设施应用等领域。

8、研发投入情况

公司持续提升研发水平，不断完善技术储备和产品布局，2025 年研发投入达到 2.08 亿元，同比增长 18.34%，为历史同期最高水平，为进一步丰富公司的业务结构、提升公司的盈利能力和综合竞争力奠定了坚实基础。

附件清单

无